

現在のニーズに応え、究極の汎用性を実現

Meet Voice of Production Lines with Ultimate Usability

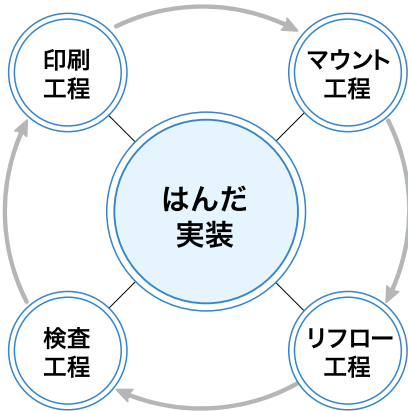
特長

- 連続作業性を向上させ、ソルダペーストの廃棄量を削減
- BGA未融合とNon-Wet Open(NWO)を抑制
- はんだ溶融時のフラックスの流動性を上げ、ボイドを大幅に抑制



Revolutionary Products

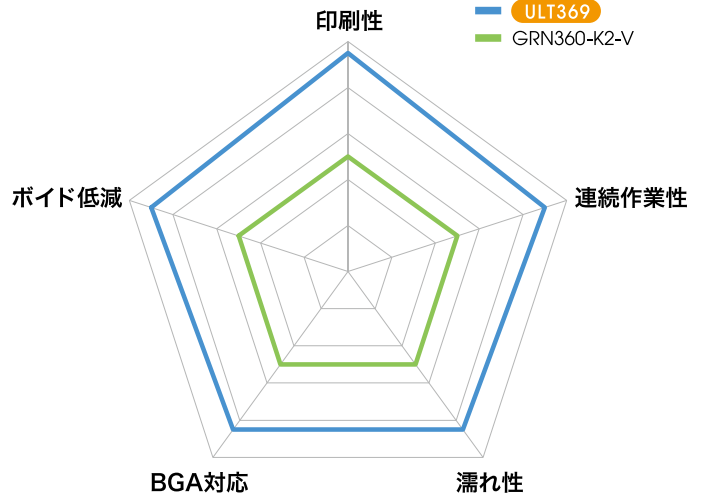
- 印刷性
- 連続作業性



- ボイド低減

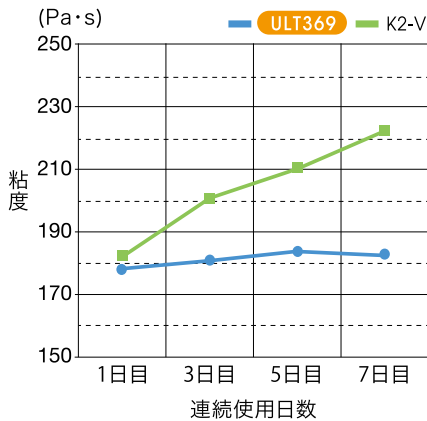
- 部品保持力

- 濡れ性
- BGA対応



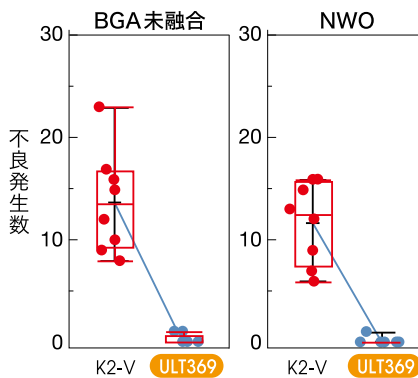
● 連続作業性の向上

印刷工程中に起きる、はんだ粉末とフラックスの反応を抑制。ステンシルライフが向上し、ソルダペーストの廃棄量を削減。



● BGA未融合とNWOを抑制

はんだとパッド間の反応を見直し、かつフラックス耐熱性を向上させることで、BGA未融合とNWOの抑制を実現。



● ボイドの低減

はんだ溶融直後のフラックスの流動性を上げることで、大幅にボイドを削減。

